3D列印應用技術研討會

近年來3D列印製造技術普遍應用於零組件、3C產品,及複雜的結構體先期設計上,本次研討會邀請3D列印技術產學專家,共同分享目前技術發展現況及未來趨勢,以及實際應用於業界的技術及研究成果,也邀請專業3D列印廠商參與展示,提供業界產品試量產代工方案及完整的解決方案,藉3D列印技術的分享和交流,協助業界在產品原型開發時,利用3D列印技術降低研發成本,開發出創新高價值產品。

誠摯邀請您來參與分享,尋找產品未來競爭力!

主辦單位:台灣電機電子學會

協辦單位:台灣天馬科技股份有限公司/財團法人台灣電子檢驗中心

時間:107年4月25日(星期三)13:00~17:00。

地點:台北市中山區松江路350號(捷運行天宮站4號出口左轉約100公尺),

台北市進出口同業公會IEAT會議中心11F第2會議室。

報名方式:填妥報名資料回傳E-mail: annlin@etc.org.tw

報名費用:免費參加

研討會聯絡窗口:03-3280026#137 林小姐

研討會議程:

(1 -4 H -4/10						
時間	內容	講師				
13:00-13:30	報到/及參觀展示					
13:30-13:40	主席/貴賓致詞					
13:40-14:30	高速3D列印技術與趨勢及數位製造之應用	台灣科技大學 鄭正元				
14:30-15:20	3D列印與設計開發-以環境/醫療產品為例	實踐大學 王則眾				
15:20-15:50	3D 列印應用展示廠商交流(敬備茶點)					
15:50-16:40	3D列印原型開發經驗分享	RealFun3D列印 黃嘯川				

「3D 列印應用技術研討會」- 報名表

公司名稱				統一編號	虎	
公司地址				公司電記	舌	
參加人員姓名	職稱	分機	行動電話			E-mail

議程內容簡介及講師介紹

高速3D列印技術與趨勢及數位製造之應用

介紹3D 列印技術具大量客製化及低庫存之優勢,唯尚無法達到像大量製造般的低成本、速度、產能需求。本次將介紹目前高速3D列印技術以液態介面連續製造及光固化3D 列印與粉末融熔,兩大技術在這個方面的突破,以及鞋業如何藉此達到數位製造為案例分享。

講師:鄭正元

簡歷:台灣科技大學機械工程系副教授

台灣科技大學工程學院院長

3D列印協會理事長

寶成工業股份有限公司創新研究中心顧問

天陽航太科技公司 經濟部A+計畫顧問

法藍瓷工業局產業高值化顧問

3D列印與設計開發-以環境/醫療產品為例

說明3D列印技術如何在產品設計開發過程中提供協助,並以環保捕蚊罐、捕鼠、OK繃、口罩、舒緩便秘等環境/醫療產品實例與現場聽眾分享。

講師:王則眾

簡歷:實踐大學工業產品設計系所 副教授

國防大學中正理工學院 機械系 副教授

國防大學中正理工學院機械工程學系博士級講師

3D列印原型開發經驗分享

說明如何結合3D列印優勢,延伸至原型製作領域的優勢,讓研發過程更加快速便利,並讓設計師了解如何有效利用3D列印及代工服務資源。

講師:黃嘯川

簡歷: Real Fun 公司負責人

HTC 工業設計師 HTC Prototype PM